



(Taiwan)

## Interconnect Density Quest for Endless Melt/Hybrid Bonding is Key – April 16, 2022

互連密度追求無止境 熔融/混合接合至為關鍵

作者：[Thomas Uhrmann](#)

2022 年 04 月 16 日

在半導體製造中，3D垂直堆疊與異質整合(將多種不同元件與晶粒製造、組裝與封裝成單一裝置或封裝)，對半導體元件的功耗、效能、面積與成本(PPAC)的最佳化，是十分重要的手段。

<https://www.mem.com.tw/%e4%ba%92%e9%80%a3%e5%af%86%e5%ba%a6%e8%bf%bd%e6%b1%82%e7%84%a1%e6%ad%a2%e5%a2%83%e3%80%80%e7%86%94%e8%9e%8d-%e6%b7%b7%e5%90%88%e6%8e%a5%e5%90%88%e8%87%b3%e7%82%ba%e9%97%9c%e9%8d%b5/>